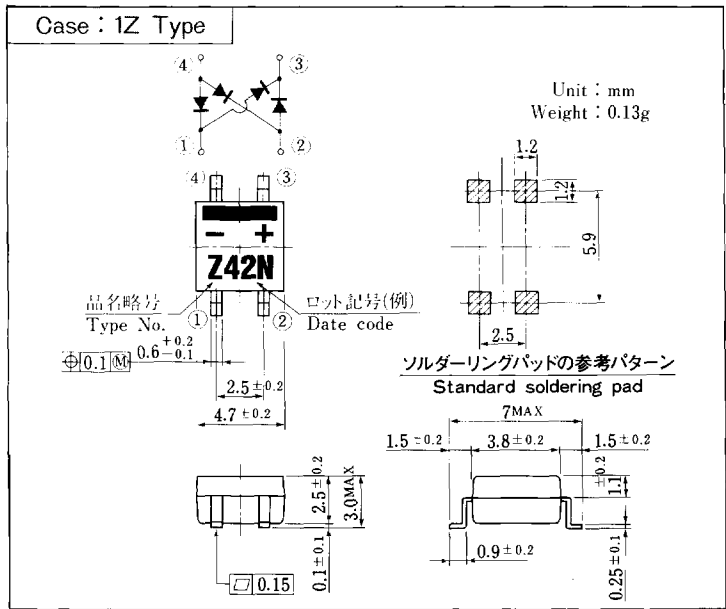


S1ZB□

600V 0.8A



外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



定格表 RATINGS

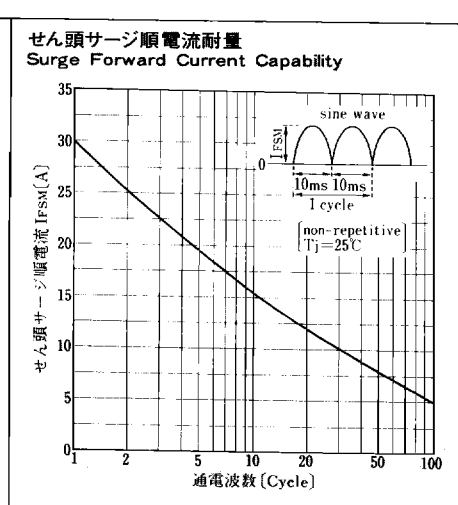
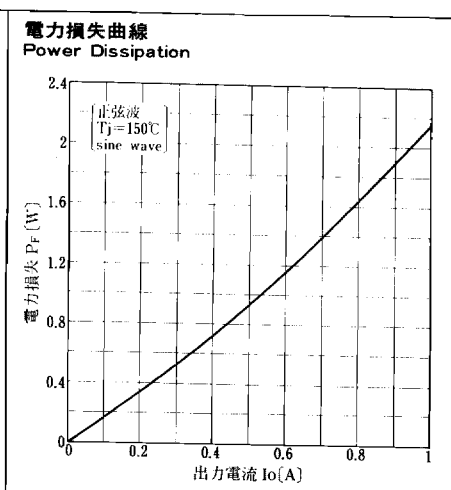
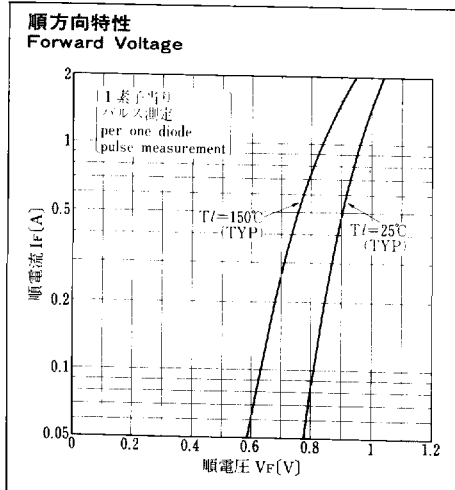
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.				単位 Unit
			S1ZB10	S1ZB20	S1ZB40	S1ZB60	
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-40~150				℃
接合部温度 Operating Junction Temperature	Tj		150				℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	VRM		100	200	400	600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	IO	50Hz正弦波, 抵抗負荷, Ta=25℃ 50Hz sine wave, R-load, Ta=25℃	アルミナ基板実装 On alumina substrate				A
			プリント基板実装 On glass-epoxi substrate				
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	IFSM	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, Tj=25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj=25℃	30				A

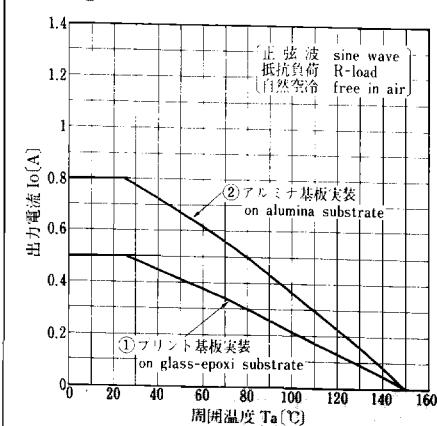
電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (Tl=25℃)

順電圧 Forward Voltage	VF	IF=0.4A, パルス測定, 1素子当りの規格値 IF=0.4A, Pulse measurement, Rating of per diode	MAX	1.05	V
逆電流 Reverse Current	IR	VR=VRM, パルス測定, 1素子当りの規格値 VR=VRM, Pulse measurement, Rating of per diode	MAX	10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θjl	接合部・リード間 Junction to lead	MAX	20	℃/W
	θja	接合部・周囲間 Junction to ambient	MAX	76	
		アルミナ基板実装 On alumina substrate	MAX	134	
		プリント基板実装 On glass-epoxi substrate	MAX		

■ 特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



デレーティングカーブ $T_a - I_o$
Derating Curve $T_a - I_o$



	①	②
フリントランド soldering land	1 mm	1 mm
導体箔 conductor layer	35 μm	20 μm
基板の厚さ substrate thickness		0.64 mm